

2017年3月期 第3四半期（2016年4月～12月） 東京エレクトロン 決算説明会

2017年1月31日

内容：

- 第3四半期連結決算の概要
- 事業環境および業績予想

代表取締役専務執行役員 堀 哲朗

代表取締役社長、CEO 河合 利樹



第3四半期連結決算の概要

2017年1月31日

堀 哲朗
代表取締役専務執行役員



2017年3月期 第3四半期のハイライト

- **SPE*四半期受注額が、過去最高**
 - 中国スマートフォンやサーバー向けの旺盛なメモリ需要を背景に、前四半期比でNAND向けが2.5倍、DRAM向けが2倍と大幅に伸長
- **CY2016のNAND向け受注額は、前年比2倍**
 - 3D NANDへの移行で当社の事業機会が拡大、NAND向け装置市場の成長率を大きく超える受注を獲得
- **FPD**四半期受注額が、FY2009 2Q以来の300億円超**
 - 当社の強みである超大型G10.5向けと大型G8向けの投資が牽引

*SPE: 半導体製造装置、**FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

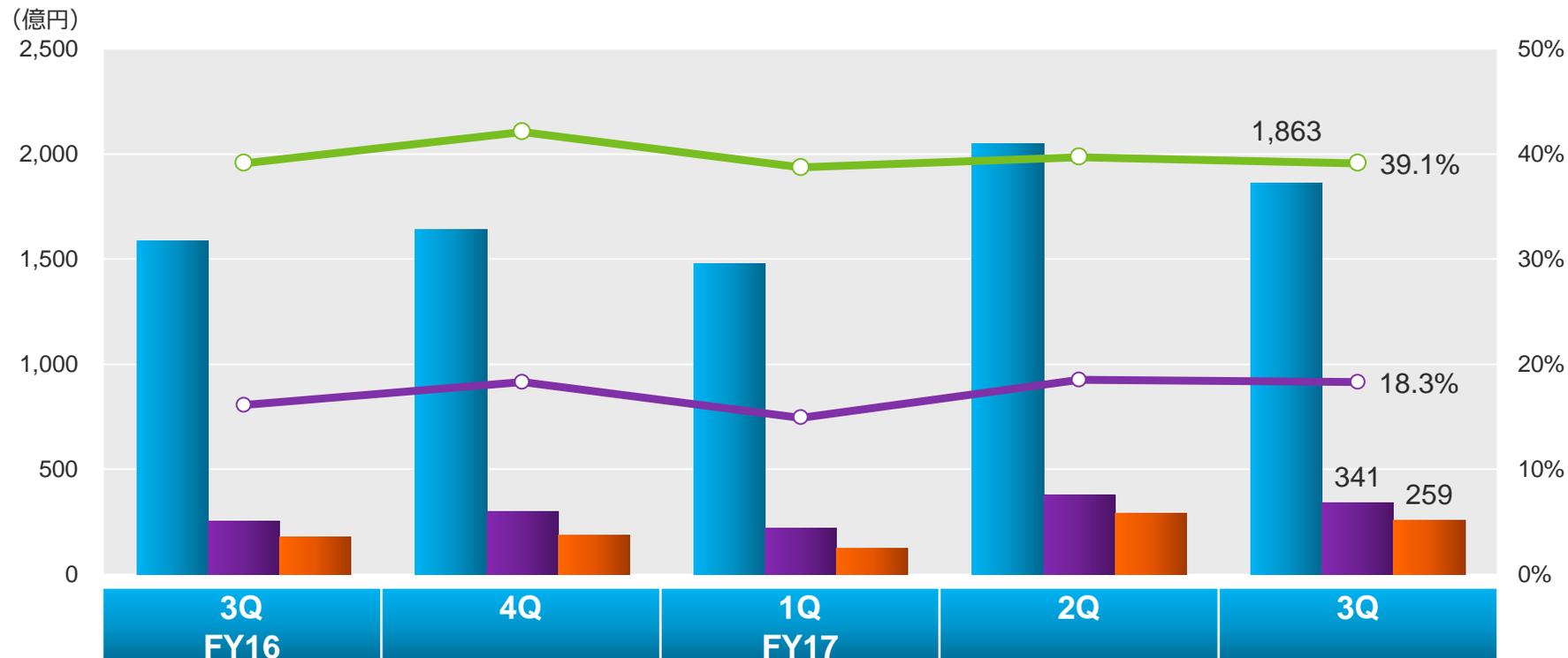
損益状況

(億円)

	2017年3月期			1Q-3Q		
	1Q	2Q	3Q	FY17	FY16	対前年同期 増減
売上高	1,479	2,047	1,863	5,390	4,997	+7.9%
売上総利益 下段：売上総利益率	573 38.7%	813 39.7%	729 39.1%	2,116 39.3%	1,980 39.6%	+6.8% -0.3pts
販管費	352	434	387	1,174	1,113	+5.5%
営業利益 下段：営業利益率	220 14.9%	379 18.5%	341 18.3%	941 17.5%	867 17.4%	+8.5% +0.1pts
税前利益	161	382	332	876	826	+6.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	126	292	259	679	592	+14.7%
研究開発費	177	220	191	589	559	+5.4%
設備投資額	38	55	41	135	76	+76.3%
減価償却実施額	39	42	45	127	142	-10.5%

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。
一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

損益状況

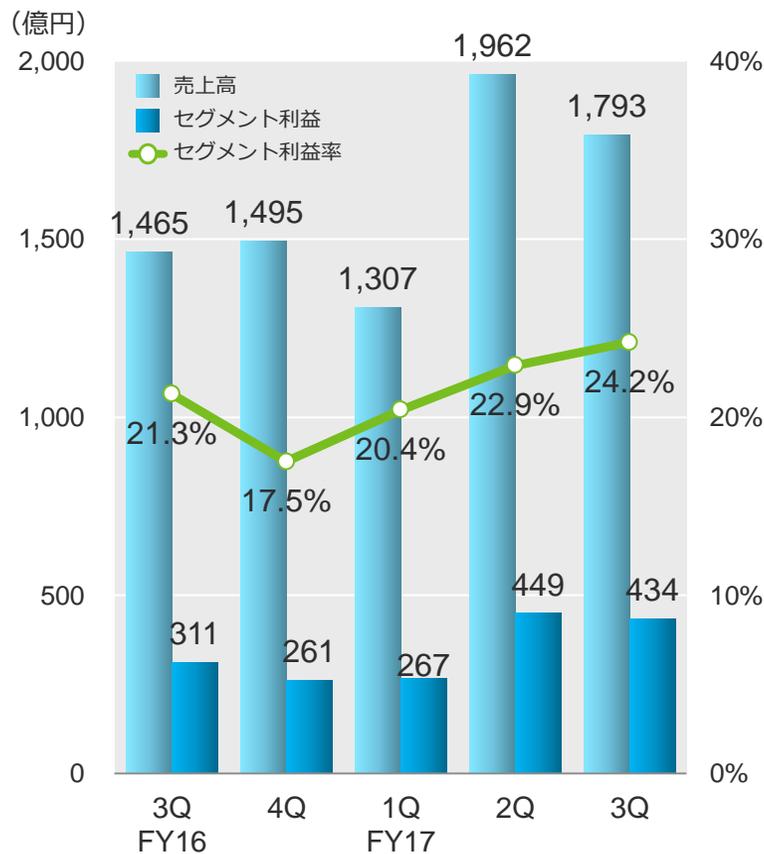


	3Q FY16	4Q	1Q FY17	2Q	3Q
売上高	1,587	1,642	1,479	2,047	1,863
営業利益	255	300	220	379	341
親会社株主に帰属する 当期純利益	178	186	126	292	259
売上総利益率	39.1%	42.1%	38.7%	39.7%	39.1%
営業利益率	16.1%	18.3%	14.9%	18.5%	18.3%

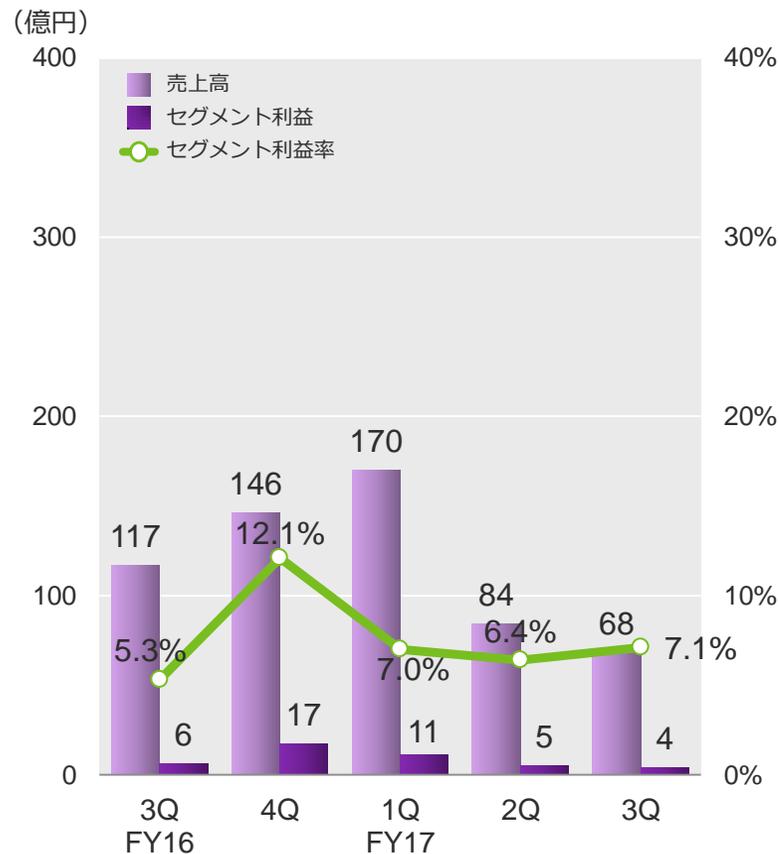
前四半期比で売上減少も、営業利益率は18%を維持

セグメント情報

SPE (半導体製造装置)



FPD (フラットパネルディスプレイ製造装置)

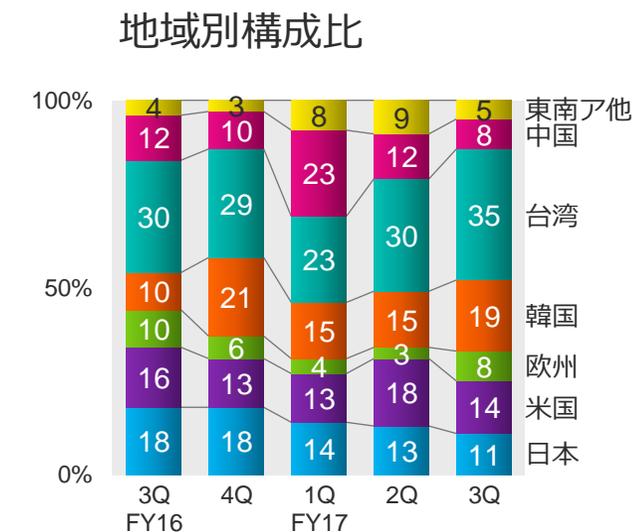
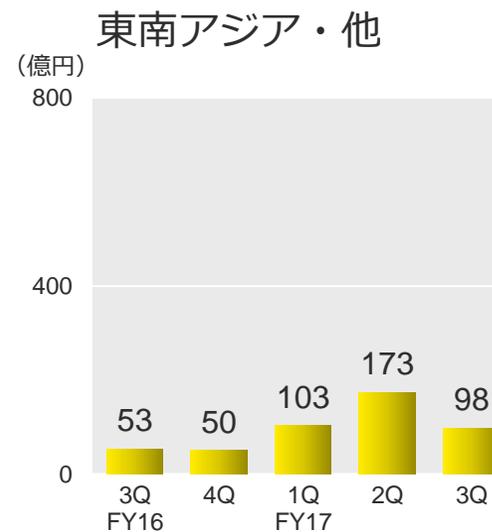
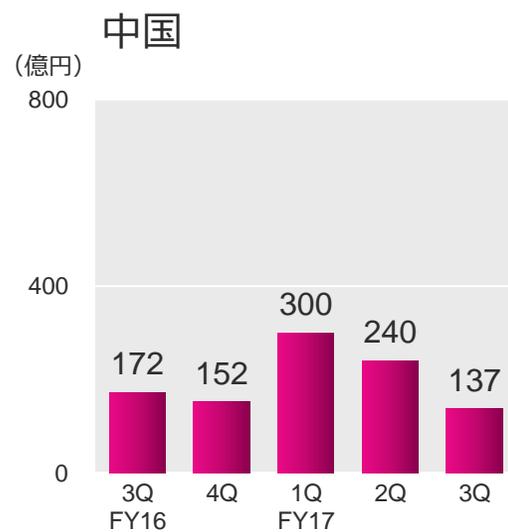
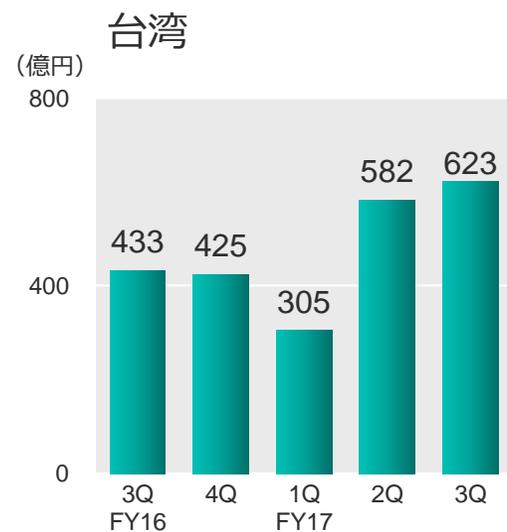
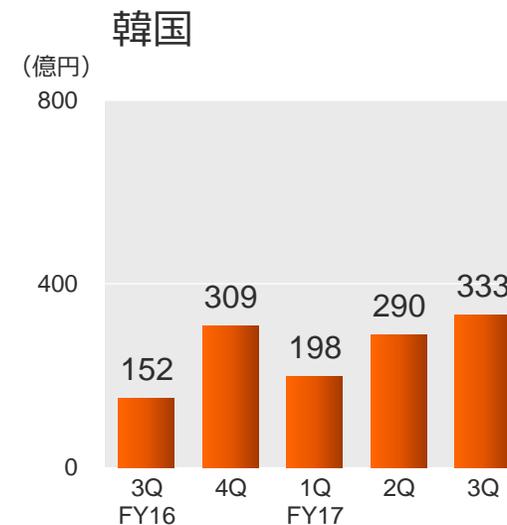
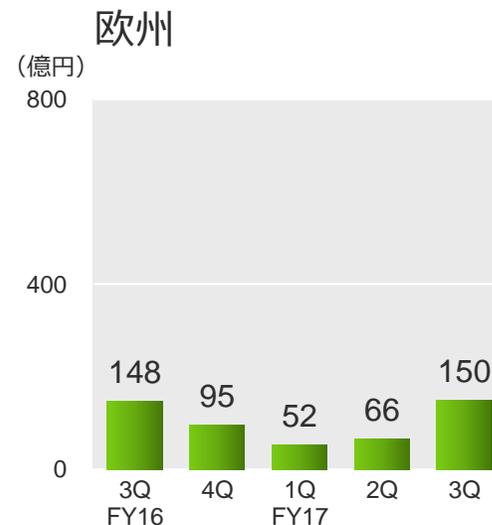
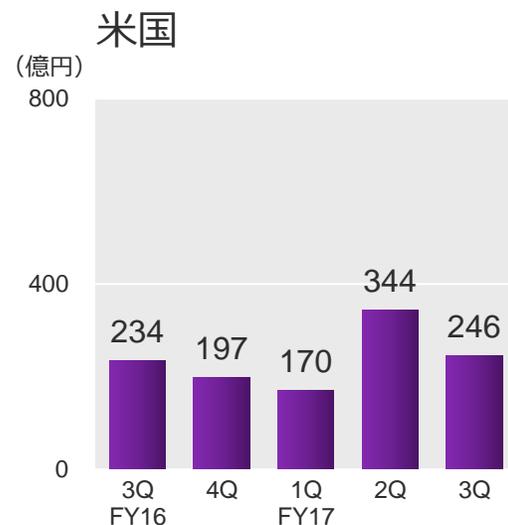
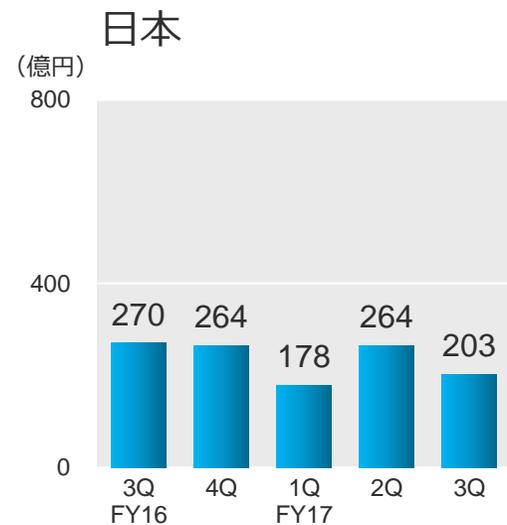


売上構成比率



1. セグメント利益は、税前利益です。
2. 上記報告セグメントに配分していない全社費用（主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費）があります。
3. 売上構成比率は外部顧客に対する売上高で算出しています。

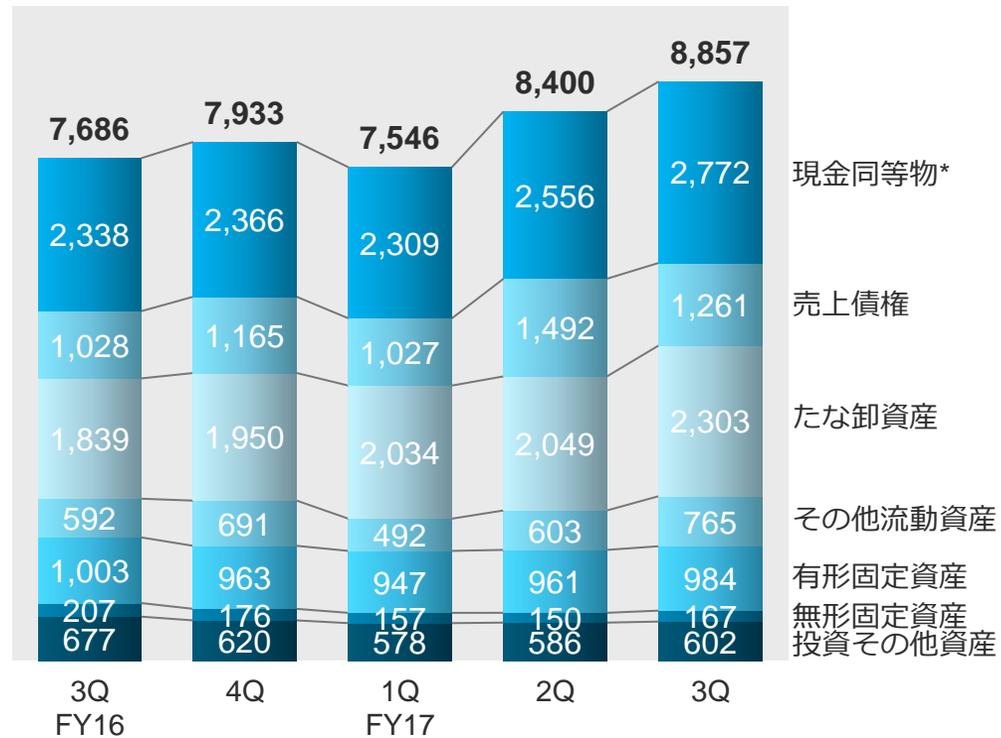
SPE部門地域別売上高



貸借対照表

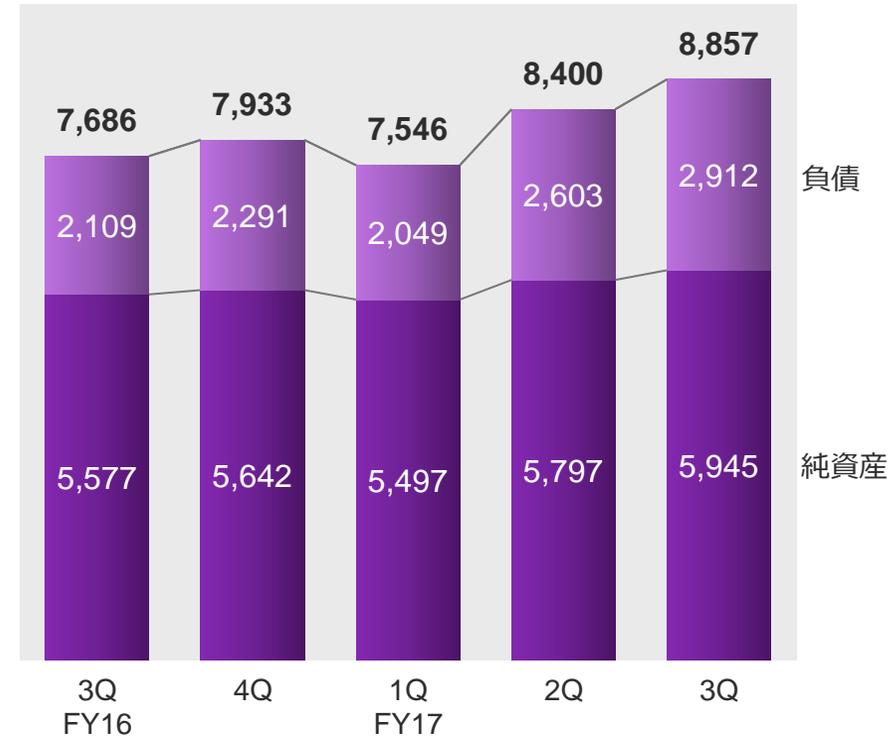
資産

(億円)



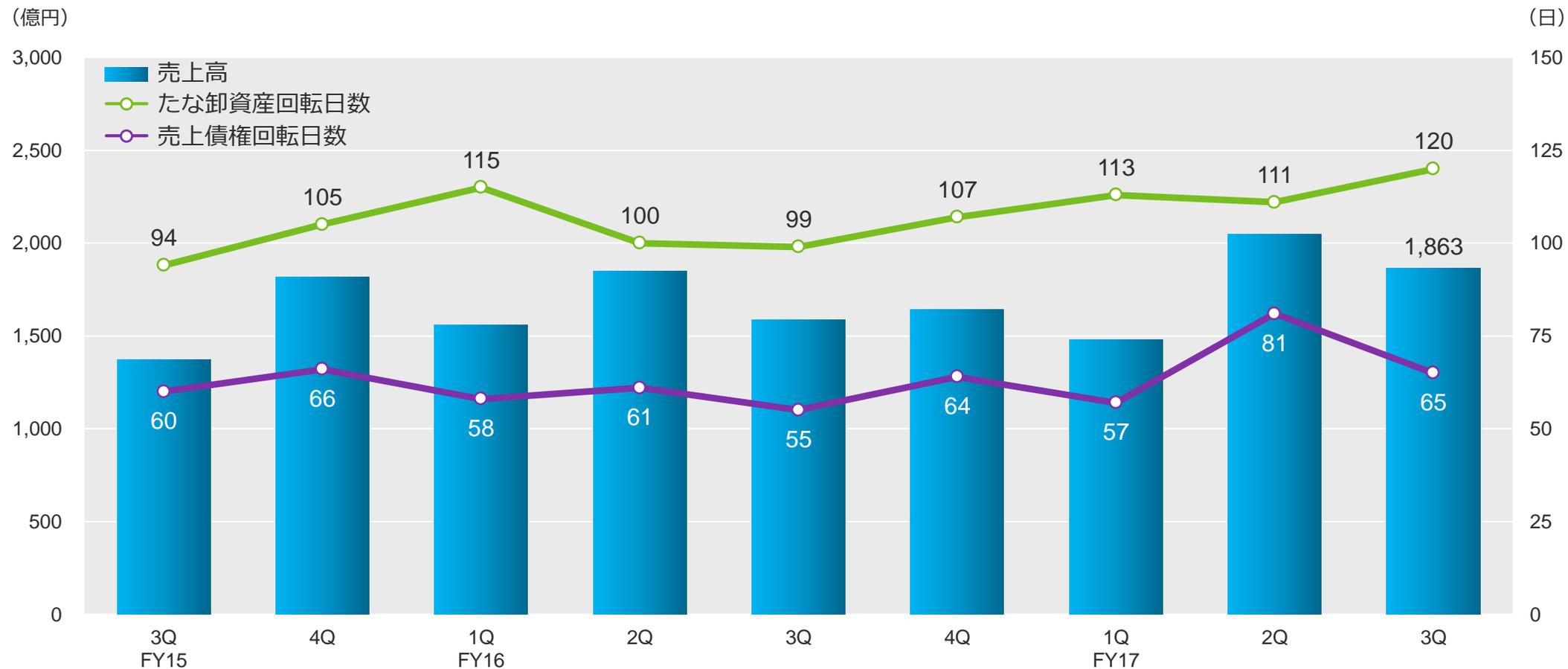
負債・純資産

(億円)



*現金同等物：現預金 + 短期投資等（貸借対照表上の表示は有価証券）

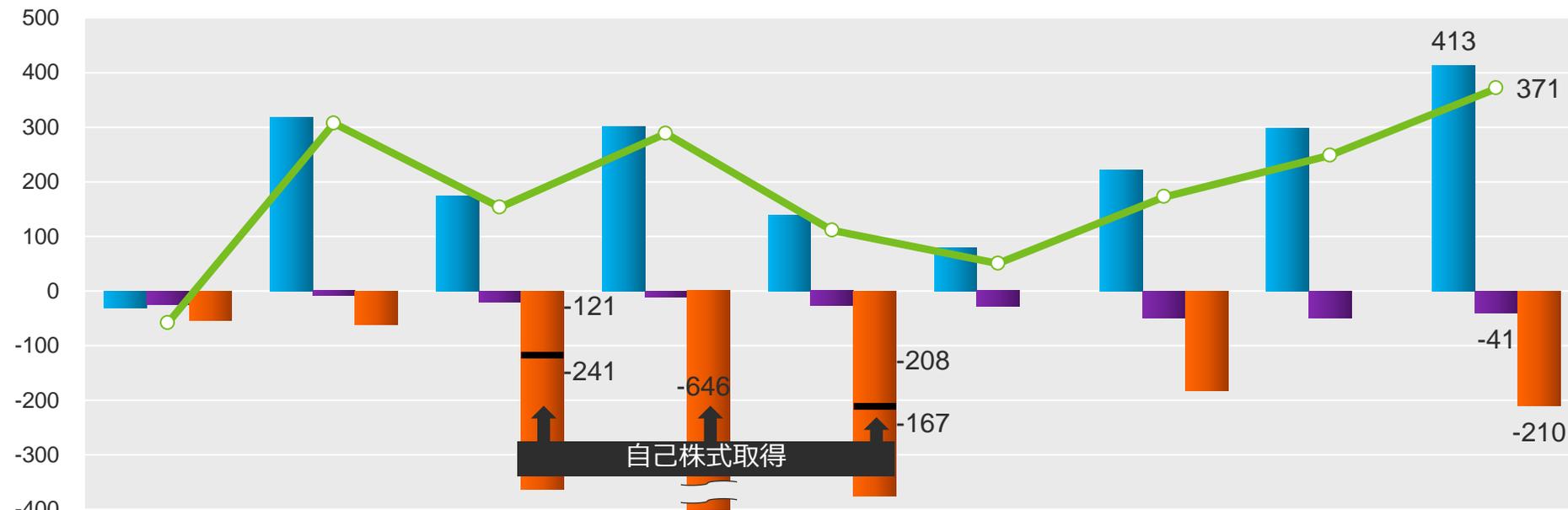
たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

(億円)

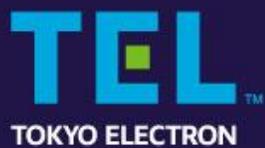


	3Q FY15	4Q	1Q FY16	2Q	3Q	4Q	1Q FY17	2Q	3Q
■ 営業キャッシュ・フロー	-32	317	173	301	138	79	221	298	413
■ 投資キャッシュ・フロー*	-26	-9	-20	-12	-27	-29	-49	-49	-41
■ 財務キャッシュ・フロー	-54	-62	-363	-646	-375	0	-183	0	-210
● フリーキャッシュ・フロー**	-59	307	153	288	111	50	172	248	371
手元資金残高***	2,853	3,176	2,989	2,607	2,338	2,366	2,309	2,556	2,772

* 投資キャッシュ・フローは、満期3ヶ月超の預金等の増減額を除いた金額です。

** フリーキャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー (満期3ヶ月超の預金等の増減額を除く)

*** 手元資金とは、現金及び現金同等物と満期3ヶ月超の預金等の合計金額です。

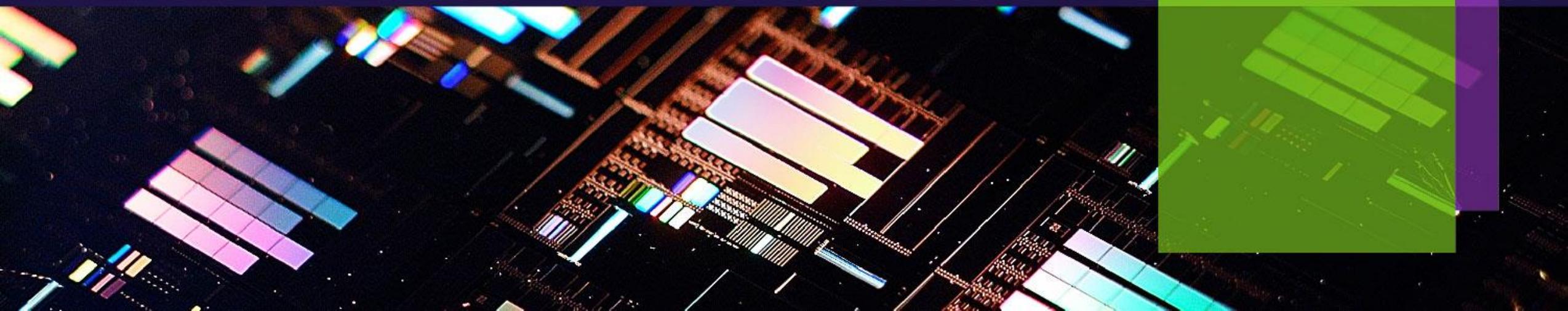


事業環境および業績予想

2017年1月31日

河合 利樹

代表取締役社長、CEO



事業環境（2017年1月時点での見方）

▶ 半導体設備投資

CY2017の半導体前工程(WFE*)の設備投資額は、次世代3D NANDおよび先端ノード向けロジック投資の立ち上がりにより、前年比10%以上の成長を予想

▶ FPD設備投資

CY2017のTFTアレイ工程**向けのFPD製造装置の需要は、モバイル用途の中小型パネル向け設備投資の継続と第10.5世代の立ち上がりにより、前年比30%程度の増加を見込む

装置市場は、IoTと次世代技術への活発な投資により成長が加速

* WFE (Wafer Fab Equipment) : 半導体製造工程には、ウェハー状態で回路形成・検査をする前工程と、チップごとに切断・組立・検査をする後工程があります。
WFEは、前工程で使用される製造装置です。

** TFTアレイ工程 : ディスプレイを駆動させる側の基板を製造する工程

CY2017 アプリケーション別の市場成長と事業機会

- NAND：前年比20%程度の市場成長を予想
 - 牽引役：データセンタ向けSSD需要
 - 設備投資：6X/7X層数世代向けが8割、2017年末に月産70万枚の生産設備を見込む
 - 事業機会：市場拡大とシェア向上、次世代9X/12X層数世代での工程拡大に注力
- DRAM：5-10%の増加
 - 牽引役：モバイルの平均搭載容量は前年比1GBの増加、サーバの搭載容量も30%増加
 - 設備投資：1Xnm世代向け設備投資が7割以上
 - 事業機会：一括パターンニング、配線工程で差別化
- ロジック／ファウンドリ：5-10%の増加
 - 牽引役：高性能化、省エネ化の需要
 - 設備投資：最先端10/7nm世代が8割以上
 - 事業機会：難易度の高まるパターンニングでのビジネス拡大

CY2017 アプリケーション別の市場成長と事業機会

■ FS事業*

- IoTの拡大と納入済み装置台数の増加により収益機会の拡大が続く
 - 中古装置、改造、パーツ、サービス
- 半導体装置メーカーの優位性を活かしたビジネス展開
 - 再製作装置、リモート接続による高付加価値サービス
- 持続的な成長を見据えた取り組み開始
 - サービス業務の効率化と在庫の最適化

■ FPD事業

- 設備投資は、当社が強みをもつ大型パネル向けが牽引（大型比率5割）
- 中小型向けに続いて大型向けにも新製品投入（PICPTM**エッチング装置）
- 第10.5世代でシェア大幅向上

* FS: フィールドソリューション **PICP : パネル基板上に極めて均一な高密度プラズマを生成するプラズマソース

四半期 受注額・受注残高

2016/10-12月期

SPE	2,671億円	(+37%)
FPD	304億円	(+103%)
合計	2,976億円	(+41%)

(億円)

3,000

2,500

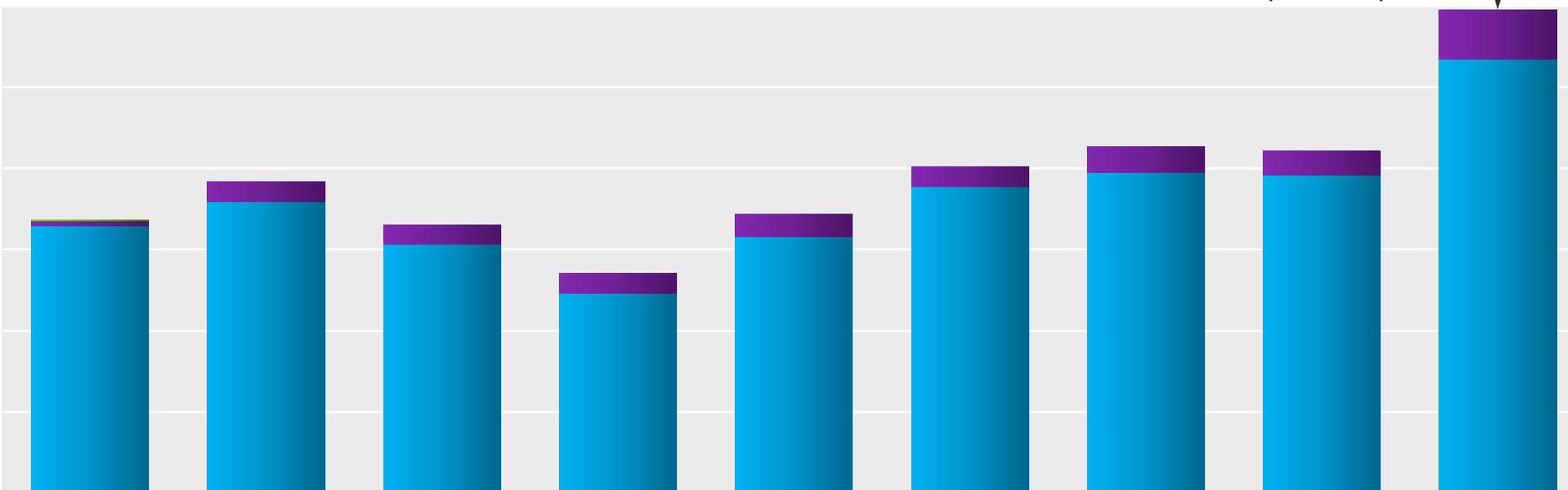
2,000

1,500

1,000

500

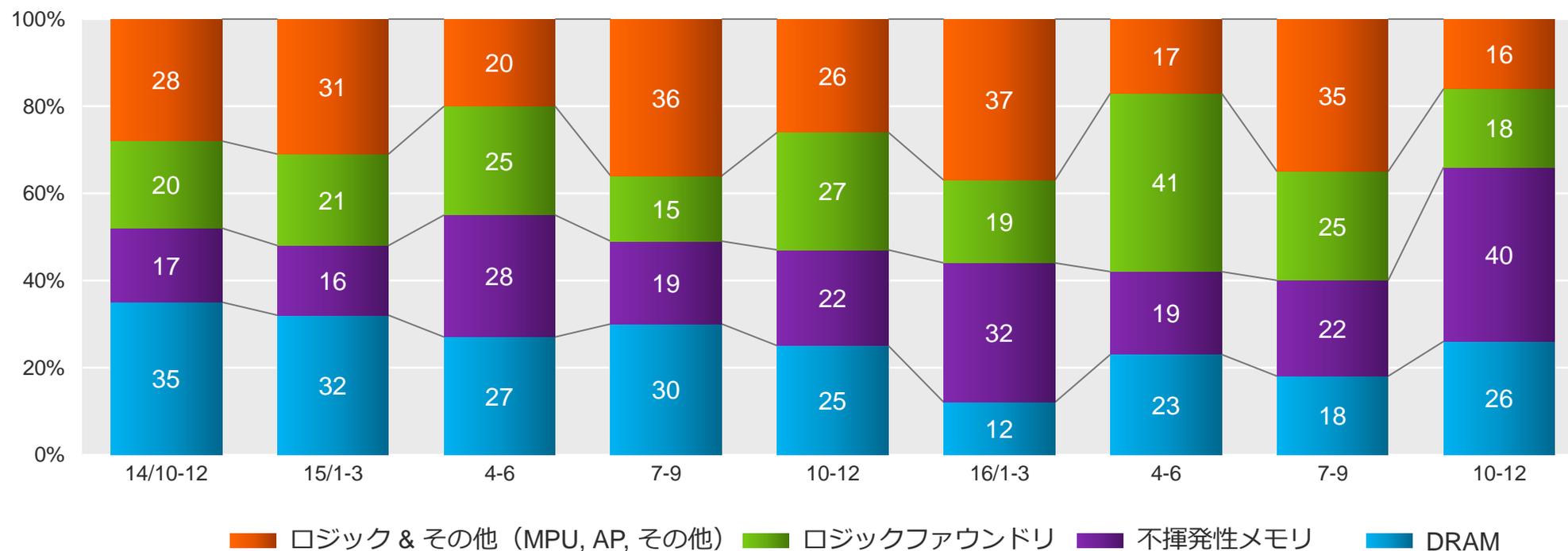
0



	14/10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6	7-9	10-12
SPE受注額	1,643	1,792	1,534	1,228	1,579	1,886	1,974	1,956	2,671
FPD受注額	34	126	118	125	139	122	159	150	304
SPE受注残高	2,457	2,533	2,664	2,126	2,241	2,632	3,299	3,294	4,172
FPD受注残高	288	316	333	376	399	374	363	429	665

2007年1-3月期を超える過去最高となる受注額

SPE受注アプリケーション別構成比

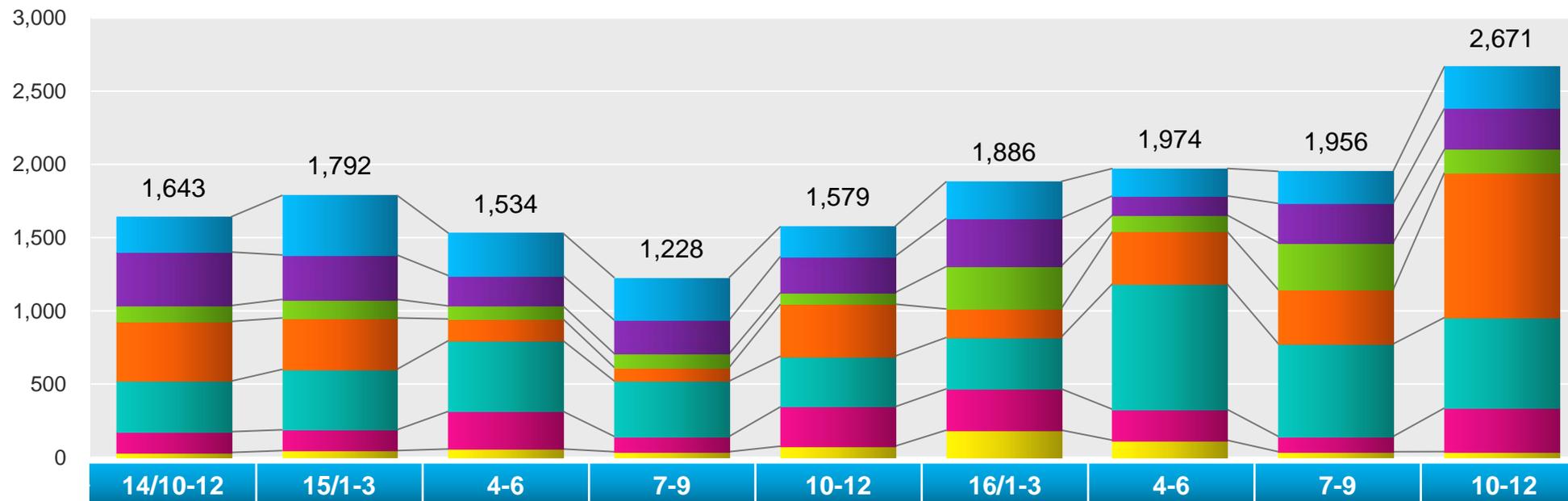


不揮発性メモリとDRAM向け投資が拡大

グラフは装置本体受注額における構成比を示しています。

地域別SPE受注額

(億円)



	14/10-12	15/1-3	4-6	7-9	10-12	16/1-3	4-6	7-9	10-12
国内	240	408	290	290	204	251	187	219	286
米国	366	303	207	229	248	329	131	269	280
欧州	108	127	89	94	79	291	112	322	159
韓国	408	351	148	93	355	194	357	369	990
台湾	345	413	483	378	346	351	858	632	618
中国	142	142	257	104	269	282	211	104	298
東南アジア・他	32	45	56	37	75	185	116	37	38

韓国のメモリ向け投資が大きく増加

2017年3月期 事業進捗と業績予想

2017年3月期 下期の事業進捗

■ エッチング装置

- 市場成長を上回る前年比14%以上の売上拡大
- CY2016 シェアはメモリにおいて向上
 - DRAM 1.8倍：パターニングの一括エッチング、配線工程
 - NAND 1.1倍：3D NANDの素子分離（スリット）工程
- CY2016 エッチング全体のシェアは 4-5pts向上の見込み
 - 投資ミックスの影響があるものの、DRAMシェアの大幅向上が寄与



プラズマエッチング装置
Tactras™

**DRAMは中期計画に向けて成果が実る
継続して2018年以降のNANDシェア向上に注力**

2017年3月期 下期の事業進捗

- 成膜装置
 - セミバッチALD装置NT333™の当期売上台数が前年比2倍
- 洗浄装置
 - メモリ向けに枚葉装置の採用が進む
- FS事業
 - 9ヶ月累積売上高1,470億円、前年同期比7%の増加
- FPD製造装置
 - 中小型向け新製品PICP™エッチング装置の収益拡大



ALD装置
NT333™



枚葉洗浄装置
CELLESTA™ -i

各注力分野ともに中期計画に向けて着実に前進

2017年3月期 業績予想 (2016/10/28発表から変更なし)

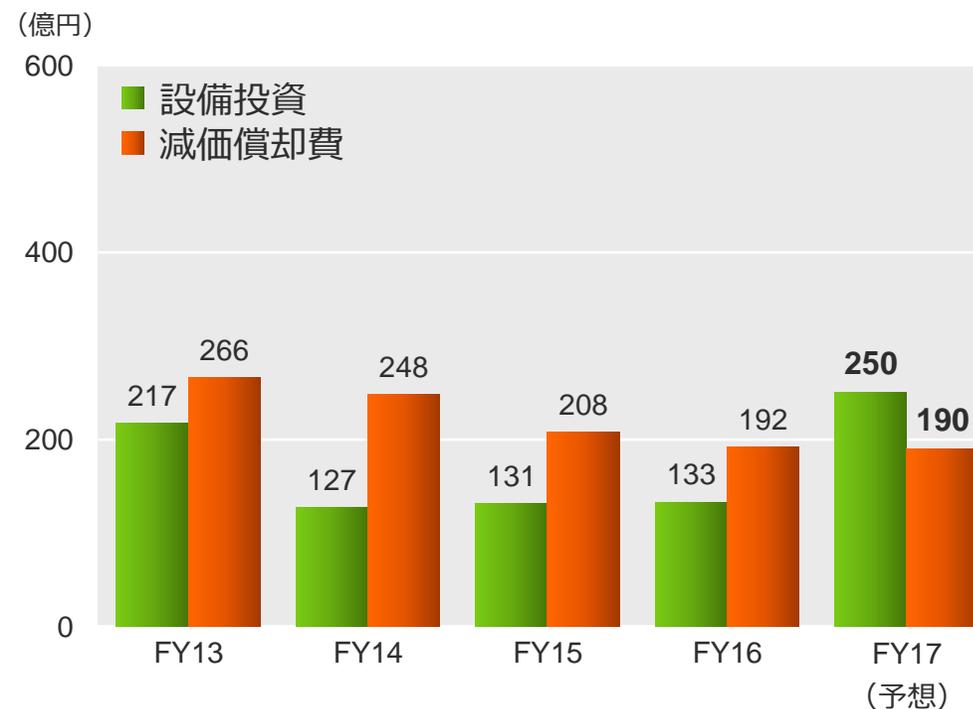
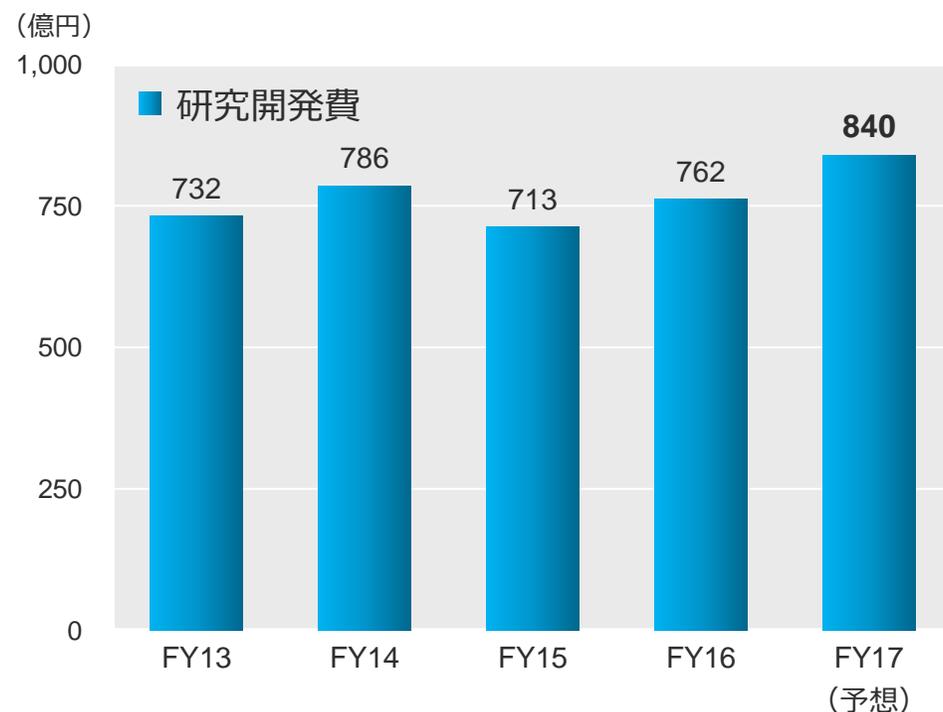
(億円)

	FY2016 (実績)	FY2017 (予想)				通期 対前年 増減
		上期	下期	通期		
		実績	予想	予想		
売上高	6,639	3,527	4,092	7,620	+14.8%	
SPE	6,130	3,270	3,854	7,125	+16.2%	
FPD	446	254	235	490	+9.7%	
販管費	1,504	786	853	1,640	+135	
営業利益	1,167	600	800	1,400	+232	
下段：営業利益率	17.6%	17.0%	19.6%	18.4%	+0.8pts	
特別損益	-129	-79	0	-80	+49	
税前利益	1,064	544	795	1,340	+275	
親会社株主に帰属する 当期純利益	778	419	580	1,000	+221	
1株当たり当期純利益 (円)	461.10	255.83	353.73	609.56	+148.46	

市場成長を大きく上回る、当期純利益29%の増益を見込む

SPE: 半導体製造装置、FPD: フラットパネルディスプレイ製造装置

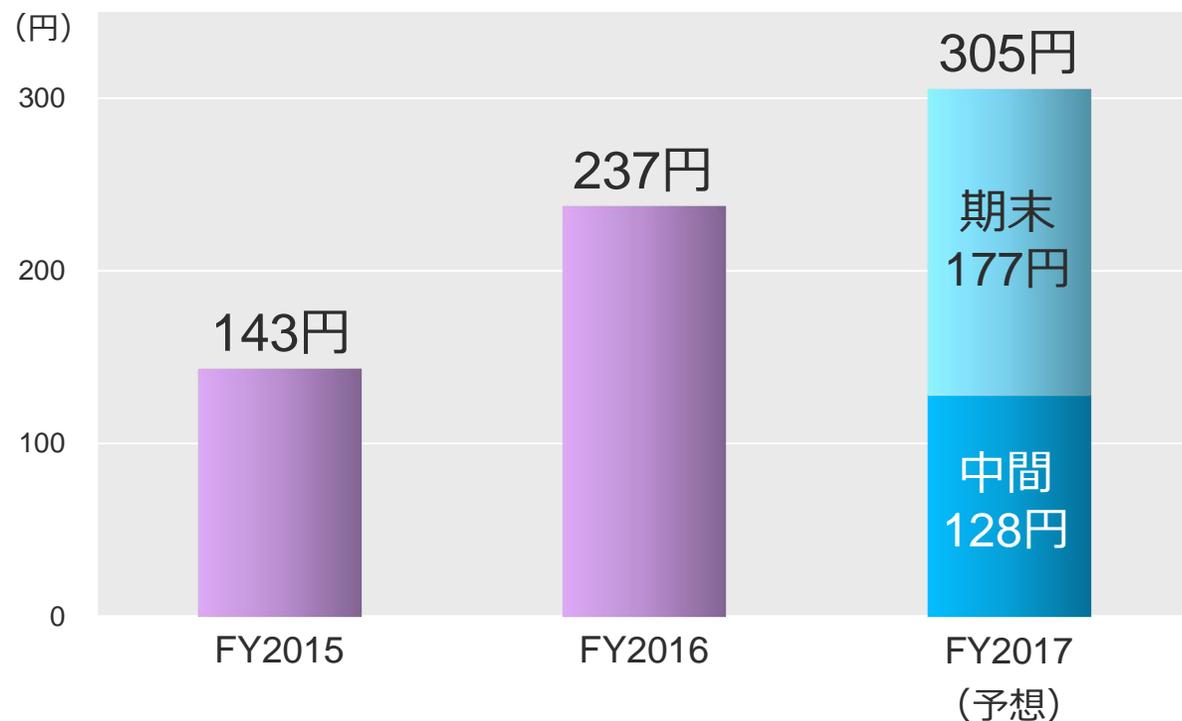
研究開発費・設備投資計画 (2016/10/28発表から変更なし)



成長分野への開発費および設備投資を増加

2017年3月期 配当予想 (2016/10/28発表から変更なし)

一株当たり配当金



当社の株主還元策

連結配当性向： 50%

但し、一株当たり年間配当金150円を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得： 機動的に実施を検討

一株当たり配当金は、3期連続で過去最高を更新予定

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD：フラットパネルディスプレイ